

## 思特威（上海）电子科技股份有限公司

### 关于自愿披露公司新产品研发进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

由思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）设计研发的1.8亿像素全画幅 CIS 产品成功试产。

风险提示：新产品研发成功试产到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程，且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：

#### 一、 新产品的基本情况

超高像素、大靶面的高性能 CIS 是图像传感器设计领域内的技术高点，日本企业在该领域一直处于垄断地位。近期，公司与合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”）联合推出 1.8 亿像素全画幅 CIS 产品，成功填补了本土企业在该领域的技术空白。

公司基于自身先进的 SmartClarity<sup>®</sup>-3、SFCPixel<sup>®</sup>-2 等创新技术，凭借行业领先的研发能力，使该产品支持 1.8 亿超高像素读出以及 8K 30fps HDR 视频模式。公司独有的 PixGain HDR<sup>®</sup> 技术还使该产品具备低像素读出电压、单次曝光、超高动态范围等特性。PixGain HDR<sup>®</sup> 技术更可在常规 2.8V 像素供电下将输出位宽最高扩展至 16 bit，大幅提升视频无拖尾动态范围，并明显降低像素读出功耗。

公司在超大靶面图像传感器设计中，创新地应用了双向驱动电路以及专为大阵列定制的高速并行读出架构，实现了出色的像素读出一致性；同时通过创新读出电路布局，优化光刻拼接带来的边界一致性、对准等问题，该技术也支持进一步向上扩展，支持中画幅等更大靶面。此外，公司以创新优化的光学结构兼容不同光学镜头，并支持高速相位对焦，提升产品在终端灵活应用的适配能力，为高端相机应用图像传感器提供更多选择。该产品采用晶合集成自主研发的55纳米工艺平台，并应用了双方联合开发的光刻拼接技术。

## 二、 新产品对公司的影响

1.8 亿像素全画幅 CIS 产品的成功试产，为高端相机应用图像传感器提供更多选择，推动全画幅 CIS 进入发展新阶段，助力国产高端图像传感器跻身世界先进行列。此次第一颗全画幅产品的推出也标志着思特威在专业数码影像领域的产品扩展，并将致力于打造专业级全画幅或中画幅传感器系列产品。未来，公司将继续加大技术研发投入，丰富公司产品矩阵，推动公司经营持续、健康、稳健发展。

## 三、 相关风险提示

新产品研发取得重大进展到实现大规模量产尚需一定的周期和验证流程，且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日